

▶ P I A社のD L Cは他社とどこが違うの

ドライプロセスによる被膜では、

- ・膜が剥がれる
- ・割れる
- ・複雑な立体形状に出来ない
- ・加工処理温度が高くて歪みが発生する

など問題点が多くありました。



PIAでは次のことが出来るようになりました

- ・窒素、カーボン、フッ素等のイオン注入のみでも高機能化可能
- ・密着力に優れたD L C成膜が可能
- ・離型・撥水D L C成膜が可能
- ・20 μ mの厚膜が可能
- ・立体・大面積部品でも均一処理が可能
- ・ゴム・プラスチックへも表面処理が可能
- ・非鉄金属へも処理が可能